

<b>PCB</b>	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
<b>焊接工艺要求</b>	MDC3K	MDC3K 焊接要求	V1	1/1	2025-10-18

1. 完整阅读焊接要求，并且理解之后，再开始焊接；
2. R189、R190、R18 要先按照板图丝印成型，然后躺平焊接，距离线路板 1mm；
3. R17、R19 焊接之前，需要把背面的继电器焊接完成后，把管脚剪短至 1mm 以下，然后把 R17、R19 按图成型，元件的表面距离线路板 2mm；
4. C2 管脚需按焊盘位置成型，按外形轮廓图 躺平焊接；
5. 注意焊接顺序，要先焊接 CY1、CY2，再焊接大电解电容（330u/400V）；
6. 要先焊接 RL4、RL5，并且剪掉其管脚至 1mm 以下，然后才能焊接 R17、R19；
7. 整流桥 U4 要先成型，注意正负极，成型后的安装孔要正对齐，元件的远离线路板的一面 距离线路板 7mm；
8. MOS 管 Q1 要先成型，有字的一面朝向线路板，安装孔要正对齐，其金属表面距离线路板 7mm；
9. 功率模块 U1 再元件的对角线管脚上有自然卡点，卡点紧贴线路板，元件金属面要完全平行于线路板，单点焊接固定后，确认金属面平行度，要求金属面与线路板的距离是 7mm，然后再开始焊接其他管脚；
10. 接口插件要横平竖直；
11. 洗板后，线路板的表面不能有锡珠、锡渣等残留物；
12. 所有焊盘（焊锡）的高度、管脚的高度，均不能超过 2mm，超出一个点，则为不合格品；
13. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	